

(0.80 mm) .0315"

High-Speed Masseebene Buchsenleisten

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?QSE

Kontaktträger:

Liquid Crystal Polymer

Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Oberfläche:

Au oder Sn über 50 µ" (1.27 µm) Ni

Strombelastbarkeit:

Kontakt: 2 A pro Kontakt (2 Kontakte belegt)

Masseebene:

23 A pro Masseebene (1 Masseebene belegt)

Betriebstemperatur:

-55 °C bis +125 °C

Nennspannung:

225 VAC (5 mm Stapelhöhe)

Steckzyklen (max.):

100

RoHS Konform:

Ja

Passende Steckverbinder:

QTE

Passende Kabelkonfektionen:

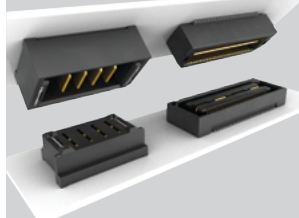
EQCD, EQDP

(Siehe Hinweis: Ebenfalls erhältlich)

Abstandshalter:

SO

Power/Signal Applikation



Kompatibel mit den Serien UMPT/UMPS für eine flexible zweiteilige Power/Signal Lösung

Blade & Beam Kontakte

integrierte Masseebene

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE		
QTE-D/QSE-D oder QTE-DP/QSE-DP @ 5 mm Mated Stapelhöhe	QSE-D/QTE-D	QSE-DP/QSE-DP
Bewertung basiert auf dem Samtec Referenzkanal. Für die vollständigen SI-Performance Daten kontaktieren Sie bitte SIG@samtec.com oder besuchen uns unter www.samtec.com	14 Gbps	28 Gbps



Verarbeitung:

Bleifrei Lötbar:

Ja

SMD-Koplanarität:

(0.10 mm) .004" max. (020-060)

Platinen Stapelung:

Für Anwendungen, die mehr als zwei Steckverbinder pro Platine kontaktieren Sie bitte ipg@samtec.com

Zertifikate:

Alle Zertifikate finden Sie unter www.samtec.com/quality



Anwendungshinweise:

- 100 GbE
- XAUI
- PCI Express®
- SATA
- MGT (Rocket I/O)
- InfiniBand™

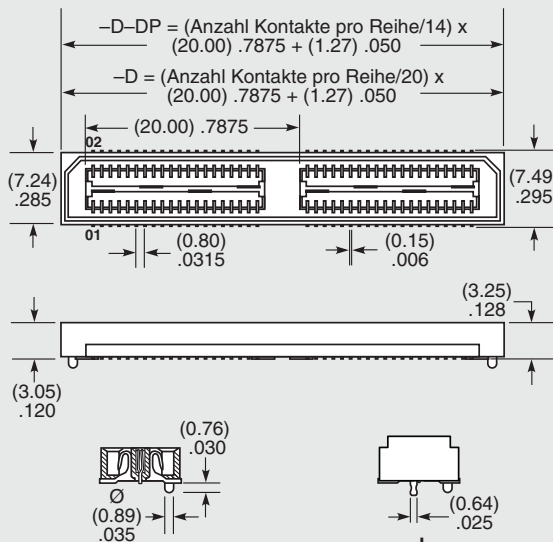
ebenfalls erhältlich (Mindestbestellmenge erforderlich)

- Stapelhöhe 15 mm, 22 mm und 30 mm
- 30 µ" (0.76 µm) Gold (Wählen Sie Kontaktmaterial -H für Data Rate Kabelkonfektionen)
- Kantenmontage
- 56 (-DP), 80, 100 Kontakte pro Reihe
- Rückhaltestift
- Kontaktieren Sie Samtec.



- 020, - 040, - 060
(40 Signalkontakte pro Gruppe = -D)

- 014, - 028, - 042
(14 Signalkontakte pro Gruppe = -D-DP)



- F = Signalkontakte und Masseebene hauchvergoldet, Anschluss Matt Zinn

- L = Signalkontakte und Masseebene 10 µ" (0.25 µm) Gold, Anschluss Matt Zinn

- C* = Elektropolierte Teilvergoldung min. 50 µ" (1.27 µm) Gold über 150µ" (3.81 µm) Nickel auf den Signalkontaktpins im Kontaktbereich, min. 10 µ" (0.25 µm) Gold über 50 µ" (1.27 µm) Nickel auf der Groundplane im Kontaktbereich. Mattes Zinn über min. 50 µ" (1.27 µm) Nickel auf allen Lötkontakten.

- D = Single-Ended

- D-DP = Differential Pair (Nur -01)

- GP = Führungspfeifen (nur -020)

- K = Ø (8.25 mm) .325" Polyimide Film Pick & Place Pad

- TR = Tape & Reel

- L = Verriegelungs-option (nicht mit -042 & -060)

QTE Leiterform	Höhe im gesteckten Zustand, mit QSE*
-01	(5.00) .197
-02	(8.00) .315
-03	(11.00) .433
-04	(16.00) .630
-05	(19.00) .748
-07	(25.00) .984
-09	(14.00) .551

*Verarbeitungsprozess kann Höhe im gesteckten Zustand beeinflussen. Siehe SO Serie für Abstandstoleranzen der Leiterplatten.

*Achtung: Kontaktmaterial -C hat den 10 Jahres MFG Test bestanden.